



FOR IMMEDIATE RELEASE

EV GROUP、次世代の EVG150 レジスト処理プラットフォームで先端光リソグラフィをけん引

*業界をリードする前世代の性能を維持しつつ、200mm 基板向けプラットフォームを再設計
モジュール容量の増加によるスループットの向上、装置フットプリントの縮小を実現*

オーストリア ザンクト・フローリアン、2022 年 11 月 7 日 — MEMS、ナノテクノロジーデバイス、半導体製造向けウエーハ接合およびリソグラフィ装置のリーディングサプライヤーである EV Group (以下、EVG) は本日、200 mm 基板対応の次世代 EVG[®]150 全自動レジストプロセス装置を発表し、光リソグラフィソリューションのポートフォリオを強化したことを発表しました。新しいプラットフォームとして設計された EVG150 は、前世代と比べて、スループットを高める(最大 80%)だけでなく汎用性をさらに向上させ、装置フットプリントも約 50%に縮小させるなど、先端機能の追加と更なる機能の拡張を実現しています。最先端パッケージング、MEMS、高周波 (RF)、3D センシング、パワーエレクトロニクス、フォトニクスなど、さまざまなデバイスやアプリケーションをサポートするユニバーサルプラットフォームである EVG150 は、高い信頼性で高品質の塗布/現像プロセスを提供します。高いスループット、柔軟性、再現性で大量生産と産業向け開発用途の両方における最も厳しいニーズに応えます。

11 月 15 日から 18 日までドイツのミュンヘンにあるメッセ ミュンヘンで開催される SEMICON Europa (Electronica と共同開催)において、当社執行役員が、この次世代の EVG150 レジストプロセス装置についてご案内します。ご希望の方は、EVG ブース #C1211 までお越しください。

次世代装置である EVG150 を導入する最初の顧客となるのは、EBS (Electronic Based Systems) の主要研究機関である Silicon Austria Labs (シリコン・オーストリア・ラボ)です。Silicon Austria Labs のマイクロシステム研究部門責任者である Dr. Mohssen Moridi は、次のように述べています。「当ラボは、大手メーカーとの共同研究を通じて、インダストリー4.0、IoT、自動運転、サイバーフィジカルシステム (CPS)、AI、スマートシティ、スマートエネルギー、スマートヘルスの基盤を構築する主要な技術を、これらが市場に出るずっと前の段階から開発を進めています。」「EVG の次世代レジストプロセス装置 EVG150 はその高い柔軟性で、EBS の技術革新を促進するために研究を進める我々の顧客とともに、新たなプロセスの確立と製品量産化の実現へと導きます。」

これまでにない柔軟性を実現したユニバーサルプラットフォーム

200mm基板対応の次世代EVG150は、前世代の全自動プラットフォームが持つ業界最高水準の性能をそのままに、スピン/スプレー塗布、現像、ベーク/冷却用のカスタマイズ可能なモジュール構成、さらには極端な段差にも対応するEVG独自のOmniSpray[®]テクノロジー、ウエーハエッジ・反り・ゆがみ・薄ウエーハなどの搬送でも高スループットを実現するデュアル・エンドエフェクター機能による現場で実証済みの高度なロボットハンドリング、などの機能の進化を遂げました。



EV GROUP UNVEILS NEXT-GENERATION RESIST PROCESSING SYSTEM.....Page 2 of 2

次世代 EVG150 200mm プラットフォームの新機能は次のとおりです：

- 最大 4 台のウェット処理モジュールスペースと最大 20 台のベーク/冷却ユニットを備え、より多くのウェーハの同時処理が可能。
- モジュール間を完全に分離。モジュール間のクロスコンタミネーションを排除するために個別化された塗布チャンバー。
- 外側から個々のチャンバーにアクセスできるようモジュール構造を再設計。チャンバーのメンテナンスのために発生する装置ダウンタイムを短縮。
- プラットフォーム内のチャンバーレイアウトを変更。ロボット搬送ユニットへのアクセスがしやすく、メンテナンスが容易に。
- 高速処理対応ウェーハプリアライメント。リアルタイムでウェーハ中心位置合わせを実現する画像処理によるプリアライナー。
- レジスト/薬液ラインを装置内に統合することで、薬液キャビネット用外部スペースを削減し、装置フットプリントを縮小。
- 装置内のユーザーインターフェース統合により、さらに装置フットプリントを縮小。

EVGのコーポレート・テクノロジー・ディレクターであるDr. トーマス・グリンズナーは以下のように述べています。「レジスト処理とパターニングは、半導体製造工程の中で最も繰り返されるプロセスです。EVG は、光リソグラフィ、スピン/スプレー塗布など、これらのプロセスで長年にわたり経験を積み、最も要件の厳しい顧客のニーズに 대응してきました。」「これらの経験から学んできた知見を存分に反映させたのが、この私たちの次世代EVG150です。スループットと所有コストを飛躍的に向上させ、多様なレジスト処理のニーズに柔軟に対応するユニバーサルプラットフォームとしてゼロから設計を見直しました。」

製品のご購入について

EVG は、新たに発表された次世代 EVG®150 全自動レジストプロセス装置の受注を開始しています。また、オーストリア本社にて製品のデモンストレーションも承っております。詳細については、こちらをご覧ください。

<https://www.evgroup.com/ja/products/lithography/resist-processing-systems/evg150/>

EV GROUP (EVG) について

EV Group (EVG) は半導体、MEMS、化合物半導体、パワーデバイスおよびナノテクノロジーデバイスの製造装置およびプロセスソリューションのリーディングサプライヤーです。主要製品には、ウェーハ接合、薄ウェーハプロセス、リソグラフィ/ナノインプリント・リソグラフィ (NIL) や計測機器だけでなく、フォトリソコート、クリーナー、検査装置などがあります。1980 年に設立された EVG は、グローバルなお客様および世界中のパートナーに対し緻密なネットワークでサービスとサポートを提供します。EVG に関する詳しい情報は <https://www.evgroup.com/ja/> をご参照ください。

お問い合わせ先：

イーヴィグループジャパン株式会社 マーケティング担当

TEL: 045-348-0665 E-mail: Marketing+CommunicationsJapan@EVGroup.com



報道関係者お問い合わせ先

Contacts:

Clemens Schütte
Director, Marketing and Communications
EV Group
Tel: +43 7712 5311 0
E-mail: Marketing@EVGroup.com

David Moreno
Principal
Open Sky Communications
Tel: +1.415.519.3915
E-mail: dmoreno@openskypr.com

###